



各 位

平成 21 年 2 月 4 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 坂 根 英 生
(コード番号 6855 東証 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 厚 地 義 尚
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、当社 100%出資の連結子会社である JEM 静岡株式会社を吸収合併することを決定しましたのでお知らせします。なお、本合併は 100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して記載しています。

記

1. 合併の目的

JEM 静岡株式会社は当社 100%出資の連結子会社であり、主として少数ピンプロブカードを製造・販売しています。当社では、平成 21 年 1 月 7 日付「経営体質強化に向けた取り組みに関するお知らせ」に記載のとおり、経営体質強化の施策として JEM 静岡株式会社の製造を当社熊本工場に統合することを決定しており、今後、更なる事業効率の向上を図るため JEM 静岡株式会社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成 21 年 2 月 4 日
合併契約締結 平成 21 年 2 月 4 日
合併の予定日（効力発生日） 平成 21 年 4 月 1 日

（注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併、JEM 静岡株式会社においては会社法 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、JEM 静岡株式会社は解散いたします。

(3) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

JEM 静岡株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債は発行していません。

3. 合併当事者の概要

(平成20年3月31日現在)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|--------|------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| (1) 商号 | 日本電子材料株式会社 (存続会社) | JEM 静岡株式会社 (消滅会社) | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業内容 | 半導体検査用部品及び電子管部品の製造・販売 | 半導体検査用部品の製造・販売 | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 設立年月日 | 昭和 35 年 4 月 6 日 | 平成 17 年 10 月 1 日 | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 本店所在地 | 兵庫県尼崎市西長洲町 2 丁目 5 番 13 号 | 静岡県静岡市駿河区国吉田 2 丁目 1 番 20 号 | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 坂根英生 | 代表取締役社長 村上信行 | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 資本金 | 983 百万円 | 80 百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 発行済株式数 | 10,604,880 株 | 1,600 株 | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 純資産 | 12,281 百万円 (連結) | 506 百万円 (単体) | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 総資産 | 16,864 百万円 (連結) | 771 百万円 (単体) | | | | | | | | | | | | | |
| (10) 決算期 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
| (11) 大株主及び持株比率 | <table border="0"> <tr> <td>(有)大久保興産</td> <td>10.67%</td> <td rowspan="5">日本電子材料株式会社</td> <td rowspan="5">100.0%</td> </tr> <tr> <td>1-ヒールシーエー</td> <td>5.54%</td> </tr> <tr> <td>大久保昌男</td> <td>4.31%</td> </tr> <tr> <td>大久保和正</td> <td>4.11%</td> </tr> <tr> <td>大久保英正</td> <td>3.83%</td> </tr> </table> | (有)大久保興産 | 10.67% | 日本電子材料株式会社 | 100.0% | 1-ヒールシーエー | 5.54% | 大久保昌男 | 4.31% | 大久保和正 | 4.11% | 大久保英正 | 3.83% | | |
| (有)大久保興産 | 10.67% | 日本電子材料株式会社 | 100.0% | | | | | | | | | | | | |
| 1-ヒールシーエー | 5.54% | | | | | | | | | | | | | | |
| 大久保昌男 | 4.31% | | | | | | | | | | | | | | |
| 大久保和正 | 4.11% | | | | | | | | | | | | | | |
| 大久保英正 | 3.83% | | | | | | | | | | | | | | |

4. 合併後の状況

| | |
|---------------|---|
| (1) 商号 | 日本電子材料株式会社 |
| (2) 事業内容 | 半導体検査用部品及び電子管部品の製造・販売 |
| (3) 本店所在地 | 兵庫県尼崎市西長洲町 2 丁目 5 番 13 号 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 坂根英生 |
| (5) 資本金 | 983 百万円 |
| (6) 決算期 | 3 月 31 日 |
| (7) 今後の見通し | <p>本合併は当社 100% 出資の連結子会社との合併のため、本合併における連結業績への影響は軽微ですが、平成 21 年 1 月 7 日付「経営体質強化に向けた取り組みに関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループの経営体質強化の施策として JEM 静岡株式会社の製造を当社熊本工場に統合することを含めた拠点の再編を行うこととしています。</p> <p>今後の業績見通しにつきましては、本日発表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。</p> |

以上